

2008年4月17日
株式会社日立製作所

最新の POWER6™を搭載した UNIX サーバ エンタープライズサーバ「EP8000 595」モデルを販売開始 従来機比約1.4倍のトランザクション処理性能向上を実現



EP8000 595 (POWER6™ 搭載)

株式会社日立製作所（執行役社長：古川一夫／以下、日立）は、このたび、高性能・高信頼なシステム向けのエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、最新の POWER6™プロセッサを最大 64way まで搭載したハイエンドモデル「EP8000 595」を新たにラインアップに追加し、4月18日から販売を開始します。本モデルでは、従来機比約1.4倍のトランザクション処理性能の向上を実現しました。

「EP8000 シリーズ」は、金融機関をはじめ、電力、交通といった社会基盤や企業の基幹業務において多くの採用実績があります。「EP8000 595」は、高い処理性能に加え、システムとしてメインフレームクラスの信頼性と可用性を備えた、ユーザーの基幹業務システムに最適なモデルです。日立独自の高速系切替機能^{*1}や日立ディスクアレイサブシステムとの連携機能などの高信頼化機能を実現するとともに、安定稼働に役立つ情報提供サービスや AIX 予防保守パッチ提供サービス、AIX ソースコード解析による緊急パッチの提供サービスといった高信頼なサポートサービスを継続し、企業、社会の情報基盤システムの安定稼働を支援します。

*1 高速系切替機能：サーバに何らかの障害が発生した場合に、すばやく現用系から待機系のサーバに切り替えることを実現する機能

■新モデルの特徴

(1) 従来機比、最大約 1.4 倍のトランザクション処理性能を実現

POWER6™(5.0/4.2GHz)を最大 64way まで搭載可能なハイエンドモデル「EP8000 595」は、POWER5+™を搭載した従来モデルに比べ、最大約 1.4 倍のトランザクション処理性能を実現しました。メモリは従来機比 2 倍となる最大 4TB、PCI スロット^{*2}は I/O ドロワー^{*3}を接続することで従来機比 2.5 倍の最大 600 スロットまで増強できます。このように、優れた処理性能とシステム拡張性を兼ね備えることにより、データベースや OLTP^{*4}など、ユーザーの基幹業務システムに最適です。

*2 PCI スロット：PCI カードを装着する差し込み口

*3 I/O ドロワー：拡張 PCI スロットやディスクドライブスロットなどを内蔵する I/O 拡張機構

*4 OLTP(On-Line Transaction Processing)：オンライントランザクション処理

(2) メインフレームクラスの信頼性と可用性を実現

従来の「EP8000 シリーズ」と同様、動的プロセッサ切り離し機能^(*5)、PCI バス障害回復機能^(*6)、命令リトライ・リカバリ機能^(*7)など様々な高信頼化機能を引き続きサポートしています。また、オペレーティングシステム(OS)は、「EP8000 595」の性能・機能を最大限に引き出す米国 IBM 社の高信頼化機能を実装した UNIX OS「AIX® v6.1」を搭載します。また、高信頼化システム監視機能「HA モニタ」と高信頼なリレーショナルデータベース「HiRDB」によるクラスタ構成において、OS の障害発生時、現用系システムから待機系システムへの切り替えを行うことができます。さらに、共有ディスクの高速系切り替えを実現するソフトウェア「HA Booster Pack for AIX」を組み合わせることにより、業務のダウンタイムを 10 数秒に留めることが可能となり、システム運用面でもメインフレームクラスの信頼性と可用性を実現します。

*5 動的プロセッサ切り離し機能：障害の発生したプロセッサを自動的に切り離して他のプロセッサで処理を継続させる機能

*6 PCI バス障害回復機能：PCI バスや PCI アダプタに障害が発生してもシステムリブートを回避してシステムを継続させる機能

*7 命令リトライ・リカバリ機能：プロセッサの内部状態を常時保持することで、エラー発生時には直前の正しい状態に復元することができ、さらに処理の再開後に障害が続く場合には予備プロセッサに処理を継続させる機能

(3) 各種最新ソフトウェアに対応

「EP8000 595」は、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能を提供する「AIX® v6.1」を採用しています。これにより、基幹業務システムで実績のある統合システム運用管理「JP1」を初めとする日立オープンミドルウェア製品に加え、「Oracle®」などの DBMS^(*8)製品や「SAP® R/3®」を含む E ビジネスプラットフォーム「mySAP.com®」など豊富な ISV^(*9)製品といった最新のソフトウェアに対応できます。

*8 DBMS: Database Management System

*9 ISV: Independent Software Vendor

■新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ(GHz)	最大プロセッサ数(way)	メモリ容量(GB)
EP8000 595	ラックマウント (専用筐体)	POWER6™ (5.0)	64	16~4,096
		POWER6™ (4.2)		

■新製品の価格と出荷時期

モデル	プロセッサ(GHz)	価格	出荷時期
EP8000 595	POWER6™ (5.0)	137,839,170 円～ (税抜 131,275,400 円～)	2008 年 6 月 30 日
	POWER6™ (4.2)	97,362,825 円～ (税抜 92,726,500 円～)	

■他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5+、POWER6 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。
- ・SAP、R/3、mySAP.com は、SAP AG のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/EP8000/>

■製品お問い合わせ先

HCA センター 電話:0120-2580-12 利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

以上

■新製品の仕様

モデル		EP8000 595 POWER6™搭載モデル	
形状		専用ラック筐体	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER6™	
	クロック・レート (GHz)	4.2	5.0
	プロセッサ数 (way)	8~64	
レベル2キャッシュ(MB *1)		4 (1wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		32 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小~最大(GB *2)	16~4,096 *3	
内蔵ディスク容量	最小~最大(GB *2)	293.6~70,464 *4*5	
拡張PCI-Xスロット本数		20 (I/Oドローアあたり)	
I/Oドローア数		1~30*6	
外形寸法(W×D×H:mm)		775×1,751×2,014 (専用42U *7 ラック筐体に搭載)	
電源電圧(V)		200~240V (三相)	
省エネ法に 基づく表示 (2007年度規定)	区分	対象外	
	エネルギー消費効率	対象外	
搭載OS		AIX® v6.1 または AIX version 5.3	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*1 1MB(メガバイト)=1,024²バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024³バイトです。

*2 1GB(ギガバイト)=1,000³バイトです。

*3 2008年11月以降サポート予定。それまでは最大2,048GBとなります。

*4 I/Oドローア30台接続時。

*5 2008年11月以降サポート予定。それまでは最大28,185.6GBとなります。

*6 2008年11月以降サポート予定。それまでは最大12台となります。

*7 ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約44.5mm)。

■他社所有商標に関する表示

- AIXは、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- POWER6は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
